

底部填充胶 CA5986-1

产品名称	底部填充胶 CA5986-1
公司名称	苏州美溪电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市玉山镇城北路1299号3F东
联系电话	0512-57785088 18013226807

产品详情

产品描述 sirnice ca5986-1是一种单组分环氧密封剂，用于csp或bga底部填充制程。它能形成一致和无缺陷的底部填充层，能有效降低由于硅芯片与基板之间的总体温度膨胀特性不匹配或外力造成的冲击。受热时能快速固化。较低的粘度特性使得其能更好的进行底部填充；较高的流动性加强了其返修的可操作性。

固化前材料性能 在 150
固化时间为3~5分钟 在 120 固化时间约为5~10分钟 注意：
底部填充位置需加热一定的时间以便能达到可固化的温度。固化曲线图会因不同的装置而不同。

使用说明
本产品室温下使用有较好的流动性，如果将基板预热到60 ，流动性将有提高。
建议使用“i”型或“l”型点胶方式。建议使用本资料中推荐的固化条件。

贮存条件
除标签上另有注明，本产品的理想贮存条件是在5 下将未开口的产品冷藏于干燥的地方。
为避免污染原装粘结剂，不得将任何用过的密封剂倒回原包装内。